Matrix Xray 苏州圣全科技有限公司

产品名称	Matrix Xray 苏州圣全科技有限公司
公司名称	苏州圣全自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区亭翔街3号
联系电话	13812633160 13812633160

产品详情

Vitrox伟特V810能够检测出多种缺陷，包括短路、断路、元件缺失、不沾锡、元件侧贴、元件立件、翘脚、锡球、 空洞 、少锡、钽电容极性贴反、多余焊锡。此外，它还能检测出生产过程中常见的一些隐蔽的焊接头缺陷，例如枕头效应 (head-in-pillow)、封装体堆叠
(PoP)、镀通孔(PTH)和多种类型的连接器接头缺陷，Matrix
Xray，检测性能远远超过市场上的其他AXI设备。

测试开发环境用户界面：采用微软视窗的软件解决方案与简单的用户界面和用户圾别的密码保护。

BGA焊球桥连是指两个或多个BGA焊球粘连在一起形成短路的一种缺陷。这种缺陷是由于BGA焊球融化后流动造成粘连导致的一种缺陷。由于这种缺陷会导致短路是决不允许的一种严重缺陷。

焊球移位是指BGA焊球与PCB焊盘未能完全对准，存在相对位移的一种缺陷。这种缺陷常常不影响电气连接，但对器件焊接的机械性能有影响。实际工作中常常允许焊球相对于焊盘有25%的位移，但是相邻焊球之间的间隙不能减小25%及以上。

圣全科技是一家专门从事工业自动化设备、技术支持、售后服务、设备租赁、安装维护、方案开发和调试检查以及工装夹具设计制造的企业。

焊球空洞是指BGA焊球中存在气泡的一种缺陷。这种缺陷往往是由于焊锡膏中的有机成分未能及时排除或焊盘未清洗干净造成的。焊球气泡对信号传输有一些影响，而更主要的影响是气泡会影响机械性能。实际工作中生产单位或使用方常常规定焊点内气泡总量不超过某一阈值，比如空洞面积小于等于焊球投影面积的25%即为合格。

Matrix Xray-苏州圣全科技有限公司由苏州圣全科技有限公司提供。苏州圣全科技有限公司是一家从事 “

苏州无损检测设备,xray无损检测,苏州探伤仪 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以 “ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使 “ 圣全 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使圣全自动化设备在工业自动控制系统及装备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象 。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！